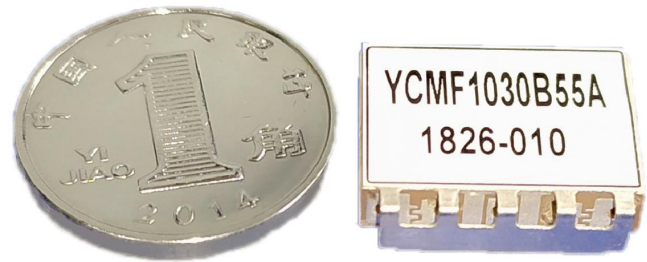


**特点:**

- 低时延:  
最大值 20ns @ $f_0$
- 良好的带内驻波比: 典型值 1.6:1
- SMT 封装
- 工作温度: -55~+85°C
- 封装尺寸: 15.8×13.1×4mm<sup>3</sup>
- 产品执行标准为 SJ20764-1999

**图片:**

**性能参数: (T<sub>A</sub>=25°C, 50Ω系统)**

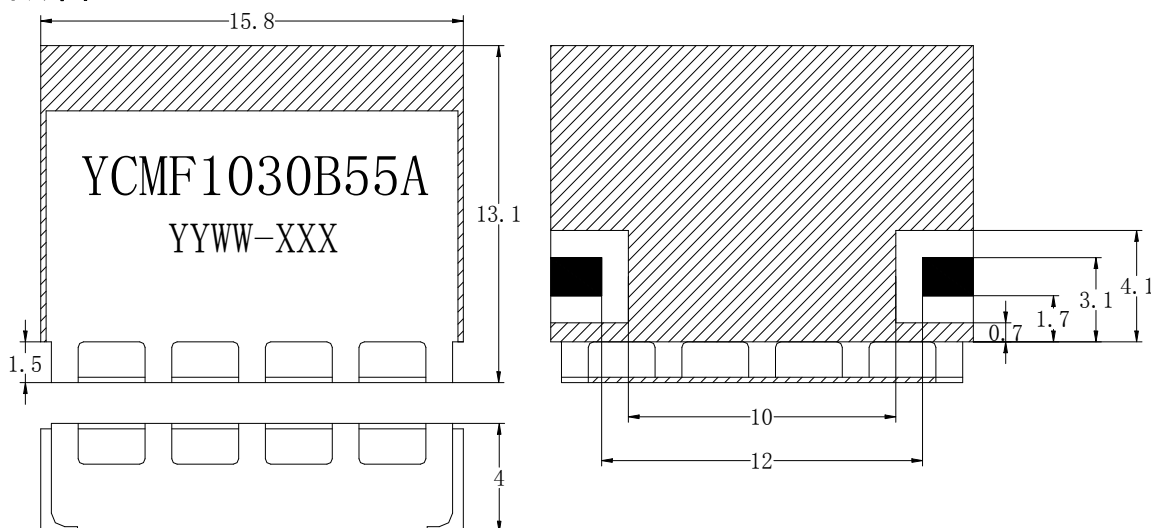
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
中心频率	$f_0$		1030±5			MHz	全温
-3dB 带宽	BW <sub>-3dB</sub>		60		80	MHz	全温
插入损耗	IL	P <sub>IN</sub> =0dBm f <sub>TEST</sub> =1030MHz			2.0	dB	全温
输入带内驻波比	VSWR <sub>i</sub>	P <sub>IN</sub> =0dBm f <sub>TEST</sub> =1010~1050MHz		1.6:1	2.0:1		全温
输出带内驻波比	VSWR <sub>o</sub>			1.6:1	2.0:1		全温
带内绝对延时	T <sub>s</sub>	P <sub>IN</sub> =0dBm f <sub>TEST</sub> =1030MHz			20	ns	
阻带抑制	SR <sub>1</sub>	P <sub>IN</sub> =0dBm f <sub>TEST</sub> =1~700MHz	40			dB	全温
	SR <sub>2</sub>	P <sub>IN</sub> =0dBm f <sub>TEST</sub> =1300~1320MHz	50			dB	全温
	SR <sub>3</sub>	P <sub>IN</sub> =0dBm f <sub>TEST</sub> =1320~1800MHz	40			dB	全温
质量	m				10.0	g	

**极限参数表:**

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
贮存温度	-55~+100	°C	输入射频功率	30.0	dBm

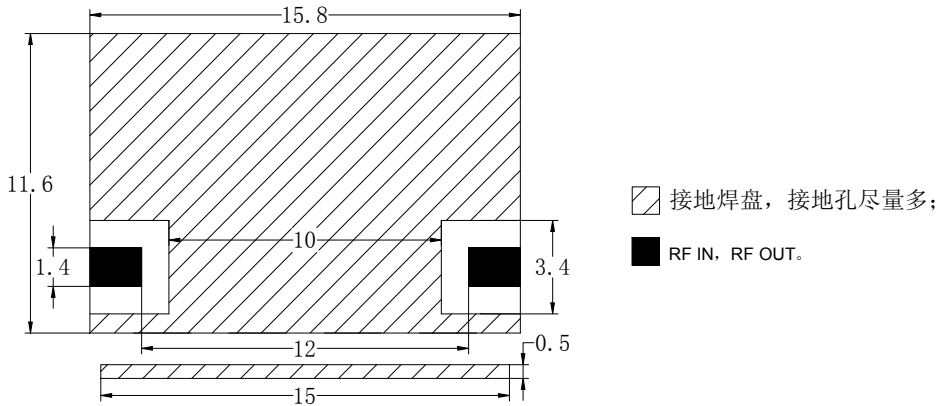
**封装外形图:**

单位: mm 公差: ±0.3mm



表面处理: 陶瓷介质镀银, 屏蔽罩镀银。

**推荐焊盘图:**



**字符标志:**

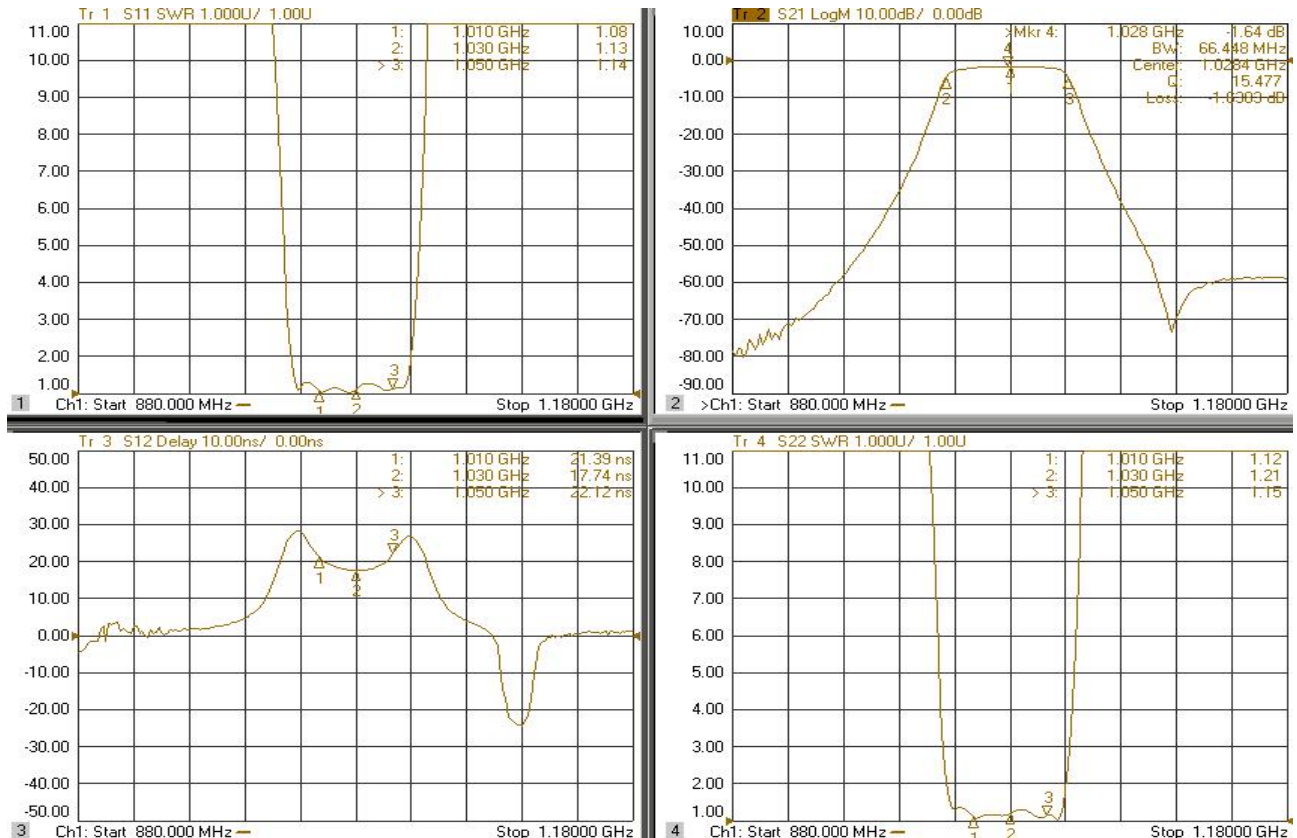
YCMF1030B55A	产品型号
YYWW	批次号
XXX	序列号

**引脚定义:**

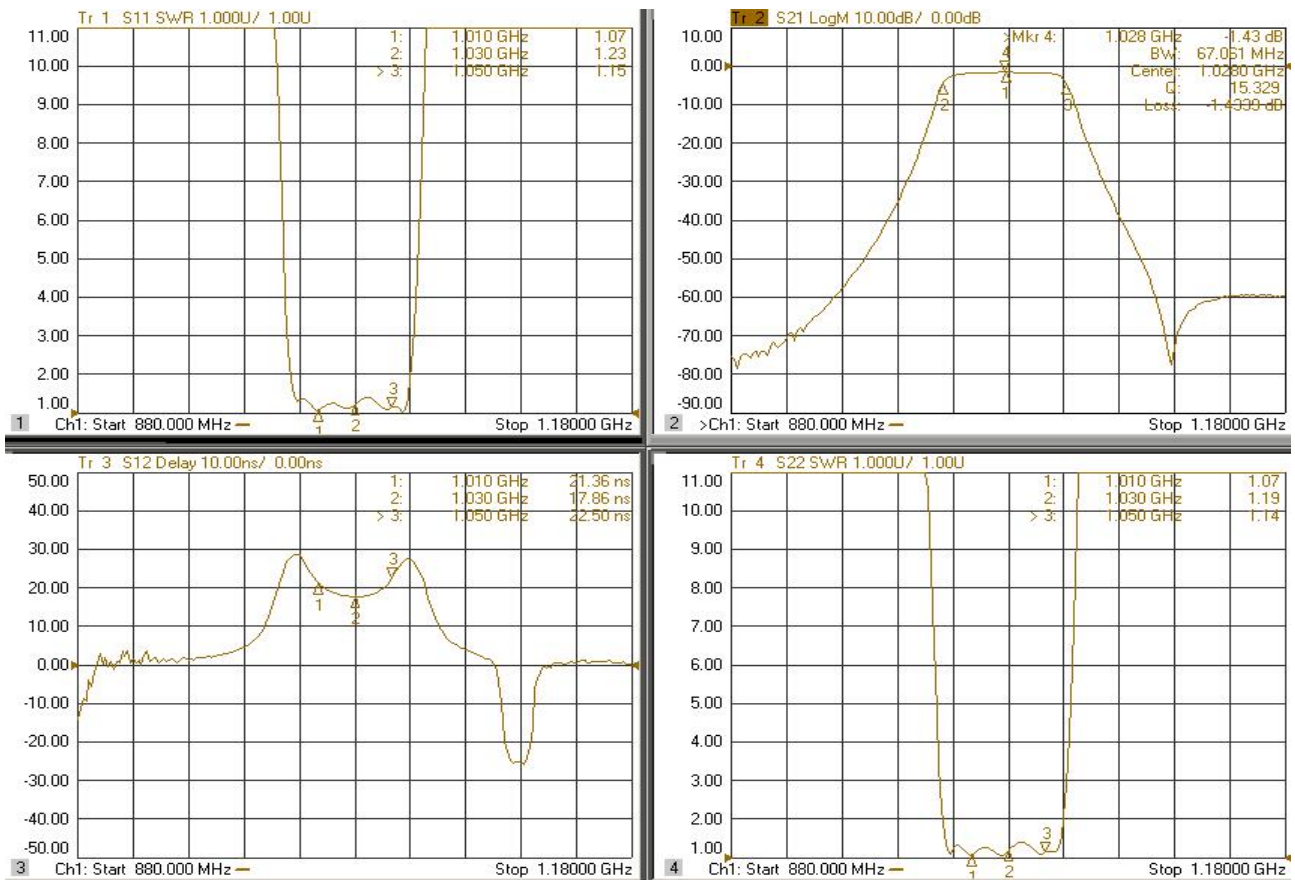
接口标识	接口说明
■	RF IN, RF OUT (可互换)
▨	GND

**测试曲线:**

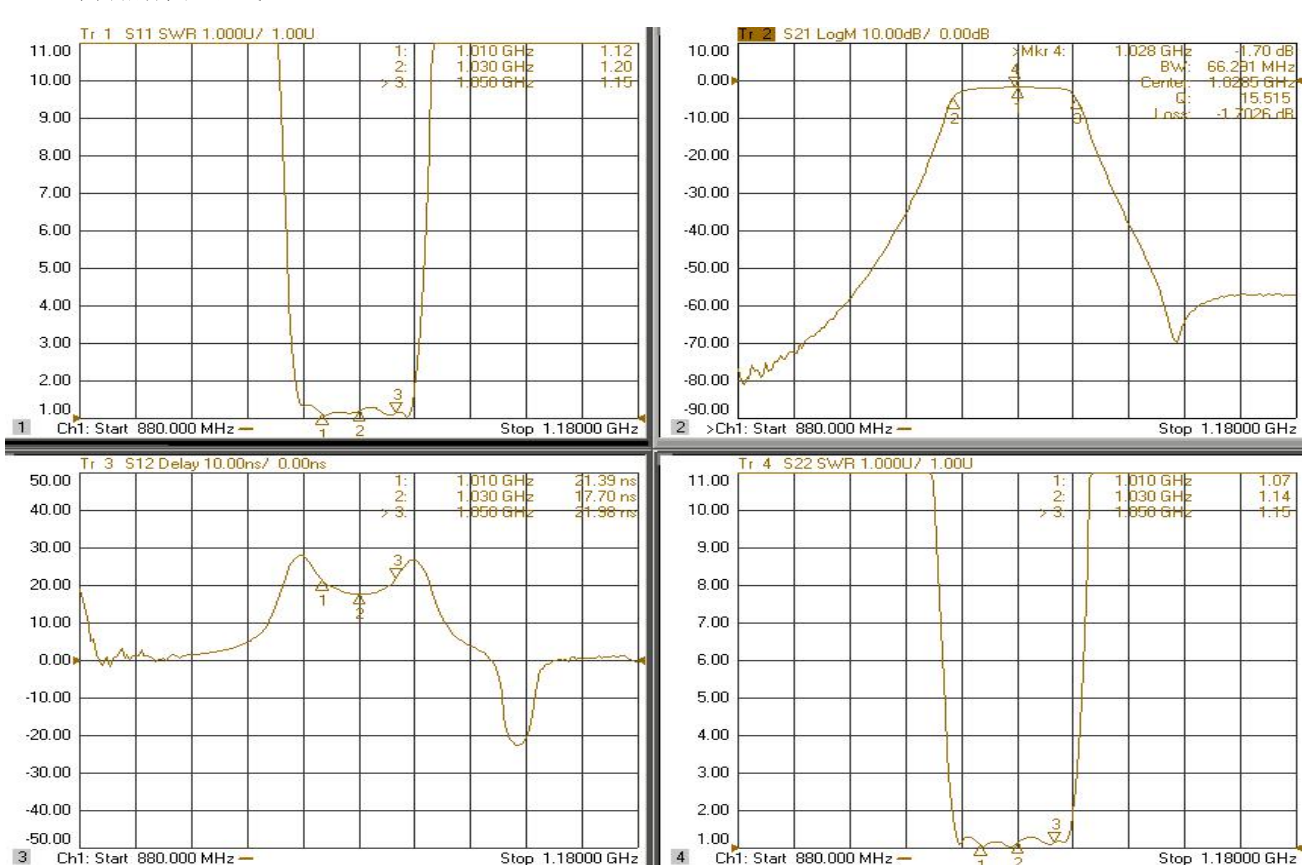
**+25℃带内指标典型曲线**



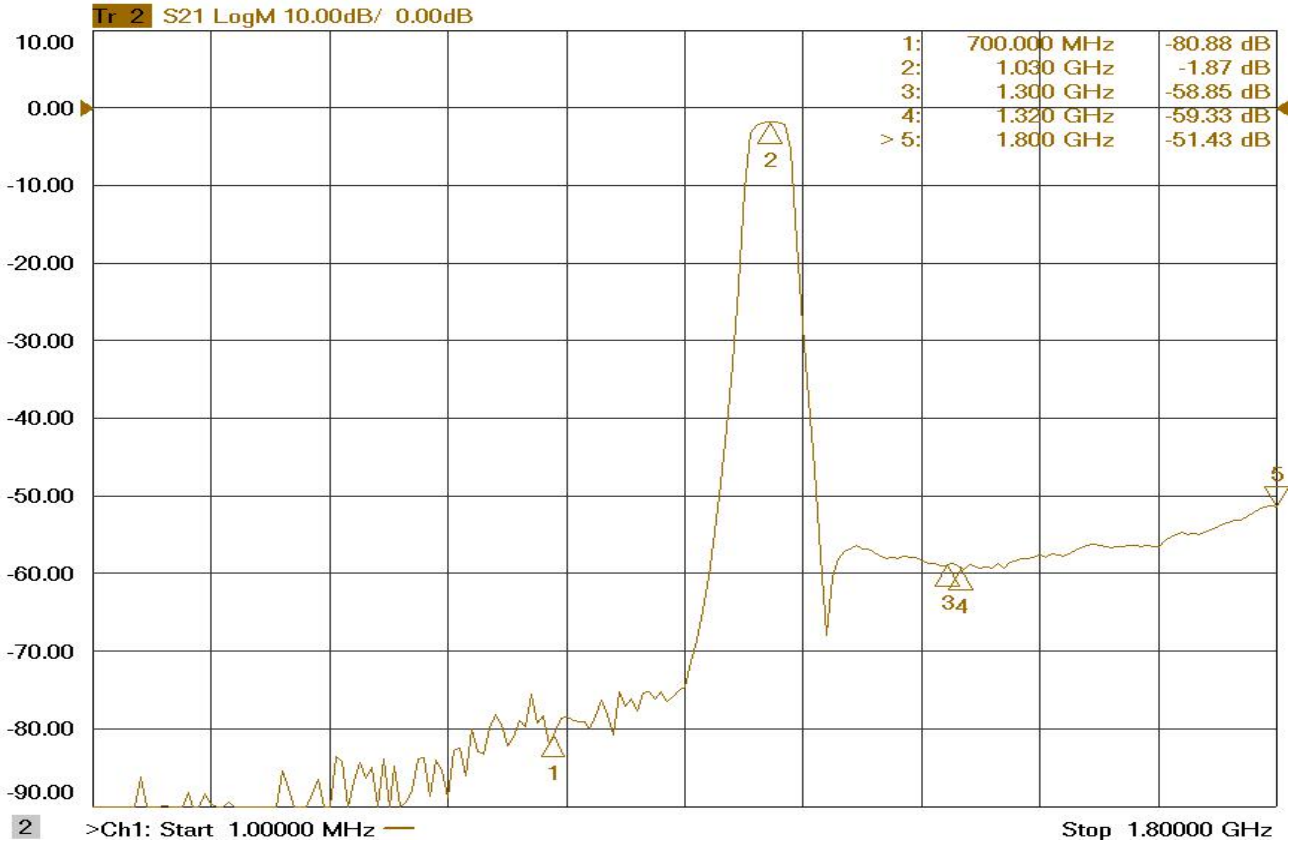
**-55°C带内指标典型曲线**



**+85°C带内指标典型曲线**

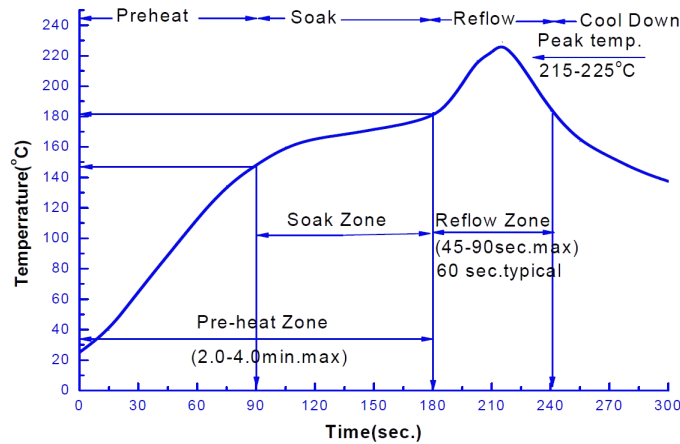


带外抑制典型曲线



产品使用注意事项:

1. 产品使用时请保证接地良好。
2. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，推荐采用采用组份≥2%的含银焊膏回流焊接，回流温度推荐曲线：



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 230℃。

3. 产品在存储时需采用密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
4. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。
5. 其他使用注意事项参考成都宇熙《微波介质陶瓷滤波器产品使用说明》。